

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	广发电子、申万电子、中信电子、华泰电子、泓德基金、长城基金、东兴基金、景顺长城基金、兴证全球基金、新华基金、银华基金、摩根基金、路博迈基金、兴业基金等100多家机构
时间	2026年4月20日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：赵奇 财务负责人：王伟 董事会秘书：张毅 芯联动力董事长：袁锋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司管理层介绍相关情况</p> <p>公司自2018年成立，始终聚焦新能源、智能化趋势，为客户提供从设计服务到可靠性测试的一站式系统代工服务，在功率器件、功率驱动与控制等多个技术领域建立国内市场领先地位。</p> <p>从战略路径上，公司规划从器件到系统代工三步走，先筑牢传感器和功率器件基础，再向驱动及控制芯片拓展，最后融合多种技术发力系统级代工方案。</p> <p>2025年度及2026年一季度，公司财务表现如下：</p> <p>（1）营收增长：2025年营业收入达81.8亿元，同比增长25.67%；2026年第一季度收入19.62亿元，同比增长13.19%。</p> <p>（2）产销情况：2025年晶圆销售量250万片，同比增长28.6%，产销率达99.62%。</p> <p>（3）盈利能力：2025年毛利率5.51%，同比提升4.48个百分点；</p>

2026年一季度毛利率进一步提升。2025年规模净利润大幅减亏38.17%，2026年一季度亏损0.88亿元，同比减亏51.53%。

(4) 折旧与现金流：2025年折旧摊销合计约39亿元，占营业收入比重收窄至47.73%，已进入下行通道。2025年经营性净现金流21.35亿元，同比增长12.19%。

(5) 研发投入：2025年研发投入19.43亿，占营业收入23.76%。

二、交流环节

1、今年一季度，公司如何看待各个下游领域的需求情况？

今年一季度，公司下游各行业需求呈现结构性分化，整体与行业趋势基本一致，具体如下：（1）汽车及汽车电子领域：一季度国内汽车行业呈现内需偏弱、出口高增态势，行业逐步走出低谷。全年行业预计前低后高，智能化、汽车电子、出海产业链仍是景气度最高的细分方向。（2）风光储新能源：风光储整体维持高景气，板块间存在明显分化，储能景气度最强，一季度国内储能装机实现爆发式增长，受益于容量电价落地、新能源配储刚需及海外需求共振，行业进入量利齐升阶段；风电装机同比高增长，国内海陆需求共振、海外市场加速放量，盈利持续修复；光伏环节价格逐步企稳，行业进入去库与盈利修复周期。（3）消费电子领域，行业整体仍处于弱复苏阶段，传统消费电子需求偏弱，但结构上呈现明显亮点：AI手机、AIPC实现结构性高增长，渗透率持续提升，产品向高端化升级，带动产业链价值量提升。公司方面，硅麦克风、手机锂电池保护芯片等代工产品持续迭代，其中手机硅麦克风在国际头部客户中市占率已超50%。同时，公司积极推进 MOSFET、惯性导航单元（IMU）芯片等产品产能提升，加强家电终端客户渗透，提供从器件到系统代工的完整解决方案。

从公司的收入来看，下游应用领域情况基本与行业整体情况保持一致。公司一季度收入同比增长13.19%。随着市场需求继续回升，二季度将有望保持收入环比实现明显提升。

2. 公司在算电协同方面的最新进展？

公司围绕算电协同已形成深度战略布局，不仅聚焦SST（固态变压器）技术前沿，更同步布局一、二、三级服务器电源全产品矩阵，构建全方位的市场覆盖能力。公司致力于为客户提供“功率器件+隔离驱动+MCU+磁器件”的完整系统代工方案。

工艺平台层面，公司高压BCD工艺持续迭代升级，8英寸SiC产线规模

化量产稳步推进，新一代SiC G2.0工艺平台在能效与可靠性上实现进一步突破。相关产品匹配AI服务器电源提功增效的需求，同时也适配以微电网为代表的风光储充变一体化的供电场景，在算电融合趋势下形成突出的卡位优势。

在超高压功率器件布局上，公司已具备3300V/4500V超高压IGBT量产能力，并持续推进更高电压等级产品研发迭代；依托自研8英寸SiC工艺平台，完成650V-3300V全电压段SiC MOSFET产品全覆盖。

AI服务器电源领域，公司已构建全层级供电解决方案，产品覆盖柔直传输、SST、绿电直连DC/DC、PSU、IBC及POL等各级应用，提供数字/模拟/功率器件一体化芯片方案。

当前核心进展包括公司已量产中低压硅基SGT MOSFET功率产品；MEMS mirror光学传感器工艺平台产品送样验证中，填补国内空白；第二代高效率数据中心专用电源管理芯片制造平台，已获得关键客户产品导入。

未来公司服务器电源相关业务收入将实现快速增长，成为核心收入增长引擎之一。

3. 公司在SiC嵌入式工艺方面的布局，如何理解对于模块业务的影响？

碳化硅嵌入式方案，是将SiC功率芯片通过基板内嵌、无键合互联、三维集成等方式实现高集成度的先进模块技术，相比传统封装具备更低寄生电感、更高功率密度和更好散热性能，能显著提升系统效率与功率密度。主要面向车载高压电驱、AI服务器电源等高端场景。

嵌入式SiC目前主要难点在于：材料热膨胀差异大易产生应力失效，高压下绝缘与局部放电控制难度高，封装工艺复杂、良率与成本控制压力大等；嵌入式SiC产业化需要终端客户、PCB厂商、封装和芯片厂商的深度联合开发。

从节奏来看，预计嵌入式碳化硅模块将在2027年前后迎来量产应用的新阶段。公司从市场需求出发，持续开发嵌入式核心芯片工艺和嵌入式方案，保证技术领先性。开发更加适配嵌入式新型芯片设计和工艺，以及嵌入式的新材料研发。目前公司嵌入式SiC方案正在送样验证中。

对产品业务而言，SiC嵌入式方案对于集成化提出挑战，公司深度配合市场需求，夯实芯片基础，开发更适配嵌入式方案的芯片、子单元和模块，加速嵌入式主驱上车市场化和量产化。

4、对于未来两年，公司的资本开支如何安排？

公司视市场情况和客户需求变化进行资本开支的安排。今明两年公司

	<p>将保持稳定的资本开支。未来两年公司产能将聚焦三大方向：一是8寸碳化硅；二是模拟IC和MCU相关的12寸产线；三是功率模组封装。公司在资本开支投入始终保持审慎态度，不希望进一步增加折旧压力。</p> <p>5、如何看待IGBT、MOSFET等相关产品涨价情况？</p> <p>公司在今年一季度已经根据市场情况对MOSFET产品进行了价格调整。从市场需求来看，IGBT产品从去年四季度至今年一季度价格走稳，同时近期市场需求有较高的增长趋势，可能会出现需求大于供给的情况。公司将密切关注市场和客户需求的变化，根据市场规律调整。</p> <p>6、公司对MCU业务如何展望？</p> <p>目前，国内在消费类或工控类MCU产品上已有较好的基础和供应，但车载领域尤其是车载域控制和节点控制MCU产品国产化率低，对应产品主要由国际厂商供应。</p> <p>公司自2022年开始研发和布局车载MCU产品。目前节点控制MCU产品已完成研发并量产；车载域控制MCU产品已进入产品验证阶段，2026年下半年望量产。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年4月20日</p>